

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-042

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保障公司健康、平稳地运营，根据 2021 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司拟向金融机构申请等值人民币 4.8 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），具体如下：

序号	金融机构名称	授信额度
1	兴业银行股份有限公司厦门分行杏林支行	10,000 万元
2	中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	10,000 万元
3	中国银行股份有限公司厦门集美支行	10,000 万元
4	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	8,000 万元
5	中信银行股份有限公司厦门分行	10,000 万元

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日